

産学官金連携フェア2019みやぎ ビジネスマッチング展示会・商談会 技術シーズ公開シート[企業]

アピール 小型化、高性能、高機能の三次元積層センサを作る

ブース番号111

テーマ 三次元積層型イメージセンサ及び製造技術
企業名 東北マイクロテック株式会社

技術シーズの概要

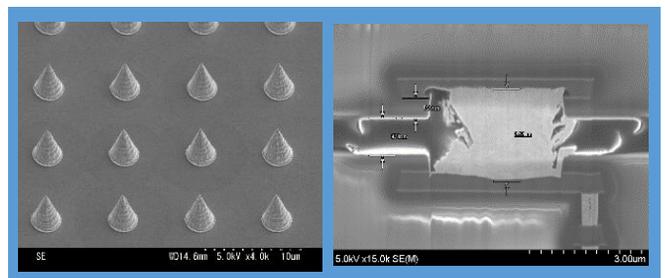
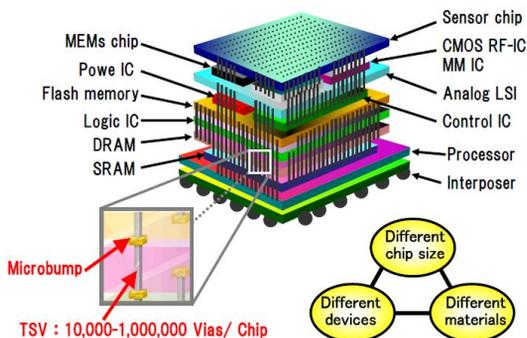
どんなシーズか？	(1) 自己組織化原理を使った、高速LSIチップ積層技術 (2) 5 μ m以下のピッチの微細金円錐バンプ接合技術
想定する市場は？	医療用X線FPD、非破壊検査用X線検出器、IoT用デバイス、等の積層型センサ/ディテクタ市場
特許の有無	PCT/JP2005/024131 日本、米国、台湾特許成立 PCT/JP2013/056330 米国特許成立

出展ニーズは？

各種S系デバイスの加工。X線センサ/ディテクタ、赤外線センサ/ディテクタを商品化している(検討している)メーカー、研究機関、Mini/ μ -LEDディスプレイ開発メーカー

連絡先

所属部署	本社		
役職・担当者名	代表取締役 元吉 真		
住所	〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40 T-Biz203		
TEL	022(398)6264	FAX	022(398)6265
URL	https://www.t-microtec.com	E-Mail	m.kikuchi@t-microtec.com



スーパーチップ

5 μ ピッチマイクロバンプ